

Robo Bonder

Roboterunterstütztes 3D-Wirebondsystem

Programm / Ausschreibung	IWI 24/26, Basisprogramm 2026, Basisprogramm Ausschreibung 2026	Status	laufend
Projektstart	22.12.2025	Projektende	31.12.2026
Zeitraum	2025 - 2026	Projektlaufzeit	13 Monate
Barwert der Projektförderung	€ 143.619		
Keywords			

Projektbeschreibung

Das Ziel dieses Innovationsprojekts ist es einen funktionsfähigen 3D Dickdrahtbonder für beliebige Bauteilorientierungen zu entwickeln. Dazu wird ein Dickdraht-Bondkopf an einem 6-Achsroboter montiert.

Projektpartner

- F&S BONDTEC Semiconductor GmbH